
GMM – Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

Nutzergruppentreffen PVD&PECVD, Ätzen

Dienstag, 12.12.2017, 10:00 bis 17:00 Uhr, Fraunhofer IISB, Erlangen

W. Robl, Infineon Technologies AG, G. Roeder, Fraunhofer IISB

GMM – Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

Nutzergruppentreffen PVD&PECVD, Ätzen 2017 – Vortragsübersicht (1)

1. Optimization of Chamber Cleans without Active Endpoint Systems
Michael Enzelberger-Heim, Texas Instruments Deutschland GmbH, Freising, Germany
2. PECVD - Remote Plasma Source Issues
Christoph Gahlert, X-FAB Dresden GmbH & Co. KG, Dresden, Germany
3. Waferedge-Residues during Plasma Etch
Steffen Groth, Nexperia Germany GmbH, Hamburg, Germany
4. Beiträge zum Thema Ätzen: Einfluss Kühlung; Prozessführung bei Spaceretch
Marcus Schoof, Elmos Semiconductor AG, Dortmund, Germany
5. Seitenwandqualität von AlCu-/AlSiCu-Leitbahnen
Nadja Griesbach, Fraunhofer IPMS, Dresden, Germany
6. Prozessführung mit Adapterwafern
Micha Haase, Fraunhofer ENAS, Chemnitz, Germany

GMM – Fachgruppe 1.2.3 Abscheide- und Ätzverfahren

Nutzergruppentreffen PVD&PECVD, Ätzen 2017 – Vortragsübersicht (2)

7. Kirkendall Voids while Cu/Sn Plating
Joachim Utzig, Nexperia Germany GmbH, Hamburg, Germany
8. Additive Manufacturing im Reinraum: Erstatzteile und Add-ons
Lukas Gerlich Fraunhofer IPMS-Center Nanoelectronic Technologies (CNT)
9. Diverse Themen
Franz Nilius TDK-Micronas GmbH, Freiburg i. Br., Germany
10. Einfluss zweier Standardwetcleans auf die Via-Ausbeute; Randabplatzungen im BEOL ; Probleme mit He-Backsidecooling beim Nitridtrockenätzen
Dirk Wolansky, IHP GmbH, Frankfurt (Oder), Germany